

EDLab基本料金

2023年4月1日改定

樹脂の種類及び開口面積により、開封に要する工数、消耗品費が違ってきますので、下記の料金は基本料金です。

開封に使用する技術により基本1時間当たり15,000円～20,000円にて基本料金を設定しています。

■ 樹脂パッケージ開封

| 開封手法 | ワイヤ | 基本料金 |
|--------------|----------|---------------------------------|
| レーザー+薬液 | Au、Al | 条件出し 20,000円～ 本番サンプル開封 7,500円～ |
| | Cu | 条件出し 30,000円～ 本番サンプル開封 10,000円～ |
| | Ag | 可否も含め応相談 |
| レーザー+大気圧プラズマ | Au、Al、Cu | 1時間当たり20,000円 |
| | Ag | 可否も含め応相談 |
| 研削・研磨+薬液 | Au、Al、Cu | 1時間当たり25,000円 |
| | Ag | 可否も含め応相談 |

■ 基板実装状態開封

条件出し 30,000円～ 本番サンプル 30,000円～

■ 層間配線剥離

| 開封手法 | ワイヤ | 基本料金 |
|------|---------|-----------------------------|
| RIE | Al 1層除去 | 1個目 15,000円～、2個目以降 10,000円～ |
| | Al 配線除去 | 5,000円～ |
| | Cu 1層除去 | 1個目 20,000円～、2個目以降 15,000円～ |
| | Cu 配線除去 | 10,000円～ |

■ ICチップの研削、研磨

1時間当たり25,000円

■ 写真撮影料金

| | |
|--------------|----------|
| 光学顕微鏡 JPEG画像 | 1枚2,000円 |
| 電子顕微鏡 JPEG画像 | 1枚3,000円 |